

CONTENTS 目次

Tokyo Electron (TEL) Overview	C2
東京エレクトロン(TEL)の事業概要	
Global TEL	1
TELの世界展開	
Industry Data	2
インダストリー・データ	
Semiconductor & TFT-LCD	4
Manufacturing Process Flow	
半導体製造工程及び	
TFT-LCD製造工程	
Consolidated Operating Results	6
連結業績	
Semiconductor	8
Production Equipment (SPE) and	
FPD/PV Production Equipment	
半導体製造装置・FPD/PV製造装置	
Consolidated Financial Data	10
連結財務データ	
Consolidated Balance Sheets	14
連結貸借対照表	
Consolidated Statements of Operations	16
連結損益計算書	
Consolidated Statements of Cash Flows	17
連結キャッシュ・フロー計算書	
Consolidated Quarterly Data	18
連結四半期データ	
Stock Information	20
株式情報	

TOKYO

ELECTRON

2010 FACT BOOK

As of March 31, 2010

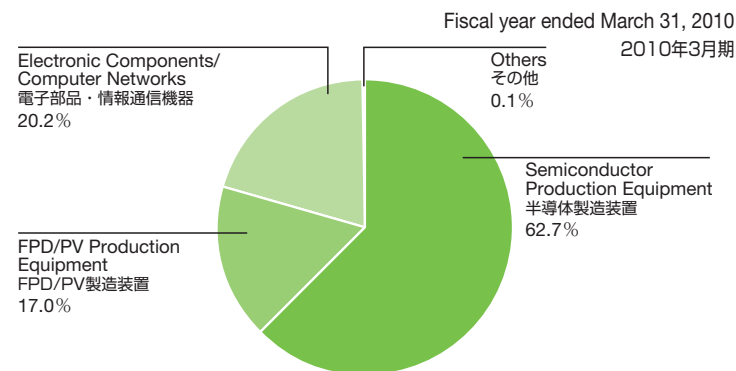
Corporate Information

会社概要

<p>Corporate Name 商号</p> <p>World Headquarters 本社所在地</p> <p>Established 設立</p> <p>Capital 資本金</p>	<p>Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社</p> <p>Akasaka Biz Tower, 3-1 Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー</p> <p>November 11, 1963 1963年11月11日</p> <p>¥54.9 Billion (as of March 31, 2010) 549億円 (2010年3月31日現在)</p>
---	---

Composition of Net Sales by Division

部門別売上構成比



Major Products and Services
主要取扱製品

As of April 1, 2010 (2010年4月1日現在)

Industrial Electronic Equipment
産業用電子機器事業

Semiconductor Production Equipment
半導体製造装置

- Coater/Developer
コータ/デベロッパ
- Plasma Etch System
プラズマエッチング装置
- Thermal Processing System
熱処理成膜装置
- Single Wafer Deposition System
枚葉成膜装置
- Cleaning System
洗浄装置
- Wafer Prober
ウェーハプローバ
- Others
その他

FPD/PV Production Equipment
FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽電池) 製造装置

- FPD Coater/Developer
FPDコータ/デベロッパ
 - FPD Plasma Etch/Ash System
FPDプラズマエッチング/アッシング装置
 - PV Production Equipment
太陽電池製造装置
- FPD: Flat Panel Display
PV: Photovoltaic Cell

Electronic Components & Computer Networks
電子部品・情報通信機器事業

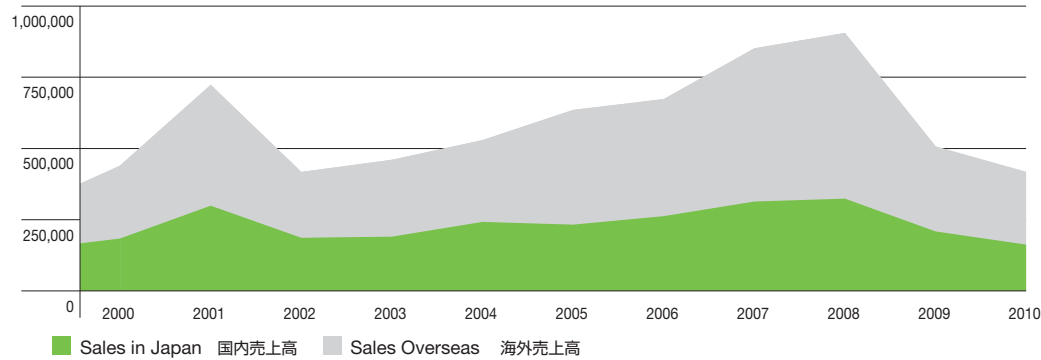
Electronic Components/Computer Networks
電子部品・情報通信機器

- Semiconductor Products
半導体製品
- Other Electronic Components
電子部品他
- Computer Networks
コンピュータ・ネットワーク機器
- Software
ソフトウェア

This product category is handled by TEL's subsidiary Tokyo Electron Device Limited.

当ビジネスは、関連会社である東京エレクトロンデバイス(株)が行っています。

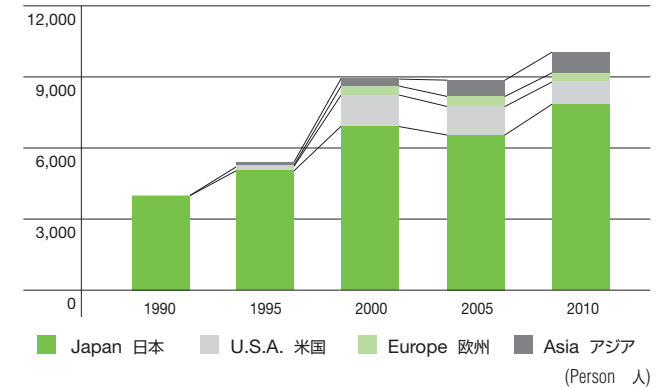
Consolidated Sales in Japan and Overseas
連結国内・海外売上高推移



(¥ Million 百万円)

FY 年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sales in Japan 国内売上高	183,987	299,272	186,516	190,513	242,318	232,677	262,531	313,816	323,946	208,870	162,608
Sales overseas 海外売上高	256,741	424,608	231,309	270,067	287,335	403,032	411,154	538,159	582,145	299,211	256,028
Total 合計	440,728	723,880	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636

Number of Employees Worldwide
ワールドワイド人員推移

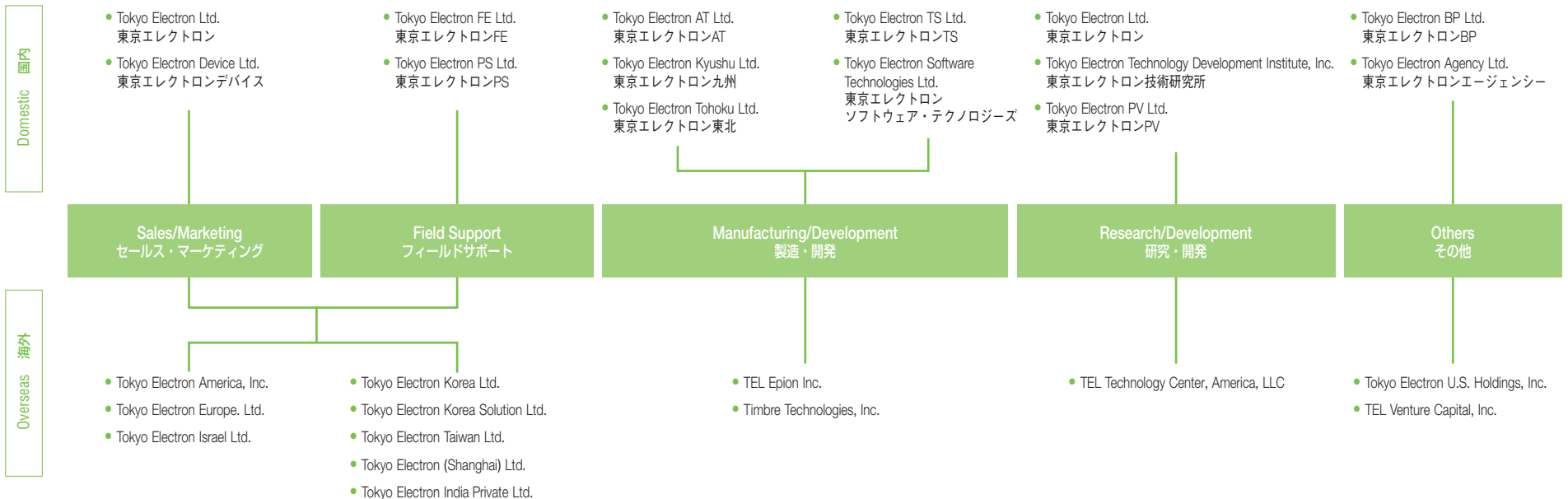


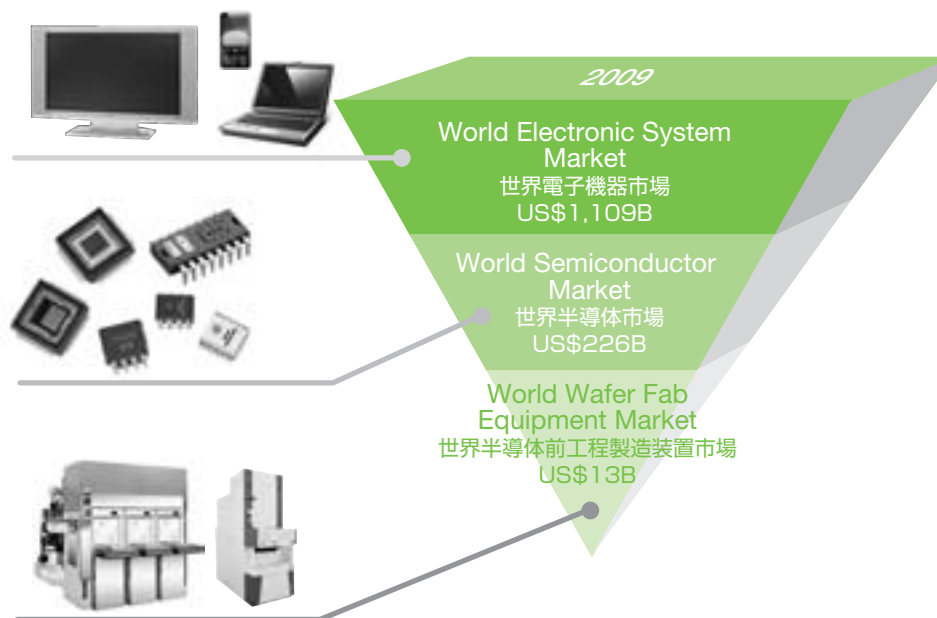
(Person 人)

FY 年度	1990	1995	2000	2005	2010
Japan 日本	3,980	5,041	6,922	6,548	7,820
U.S.A. 米国	8	192	1,315	1,205	1,017
Europe 欧州	0	51	378	425	310
Asia アジア	0	126	331	686	921
Total 合計	3,988	5,410	8,946	8,864	10,068

Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

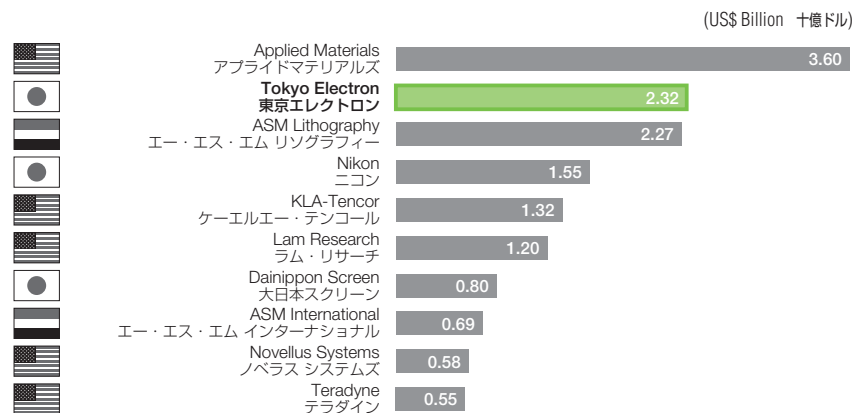
As of April 1, 2010 (2010年4月1日現在)





■ World Top 10 SPE Makers
半導体製造装置メーカー世界トップ10

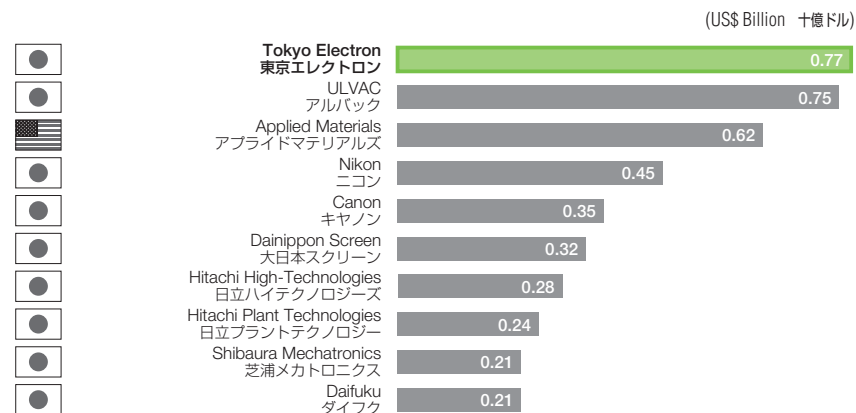
CY2009 Revenue Ranking
2009年売上高ランキング



Source: VLSI Research (April 2010)
出典: VLSIリサーチ (2010年4月)

■ World Top 10 FPD Production Equipment Makers
FPD製造装置メーカー世界トップ10

CY2009 Revenue Ranking
2009年売上高ランキング



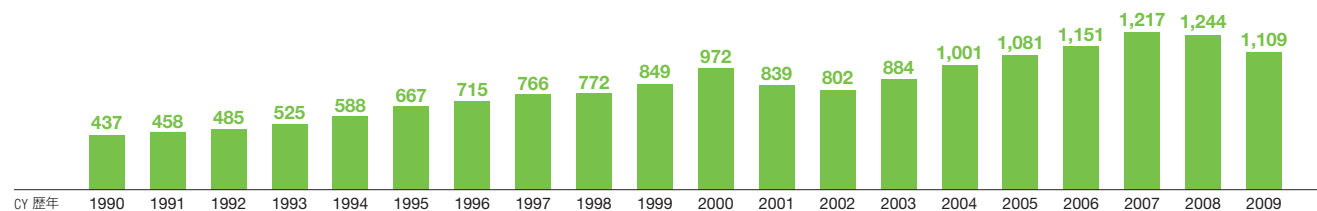
Source: VLSI Research (June 2010)
出典: VLSIリサーチ (2010年6月)

World Electronic System Market

世界電子機器市場

(US\$ Billion 十億ドル)

Source 出典：IC Insights

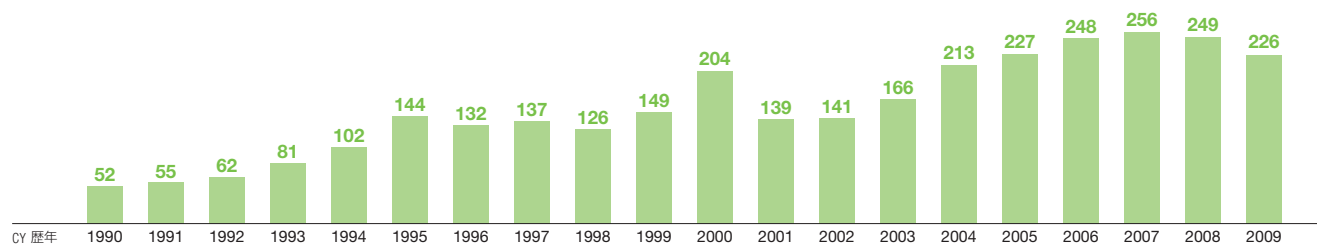


World Semiconductor Market

世界半導体市場

(US\$ Billion 十億ドル)

Source 出典：WSTS

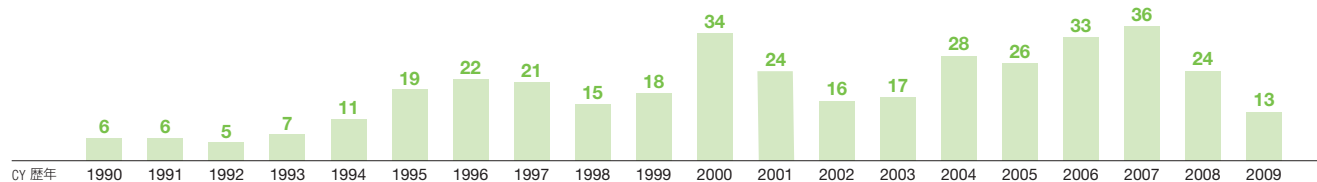


World Wafer Fab Equipment Market

世界半導体前工程製造装置市場

(US\$ Billion 十億ドル)

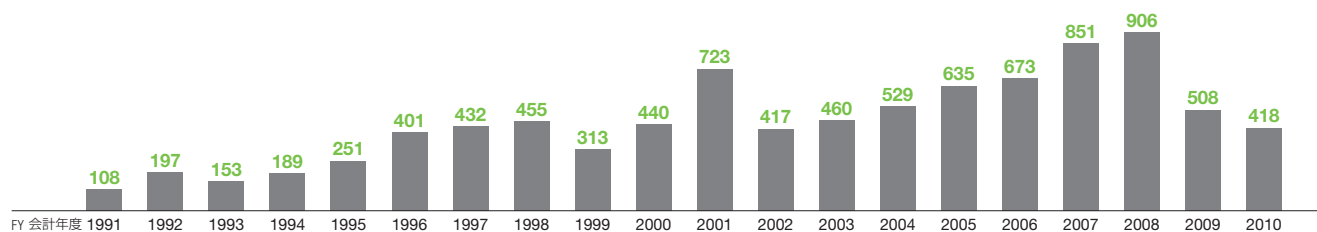
Source 出典：Gartner (June 2010)



Consolidated Sales of TEL

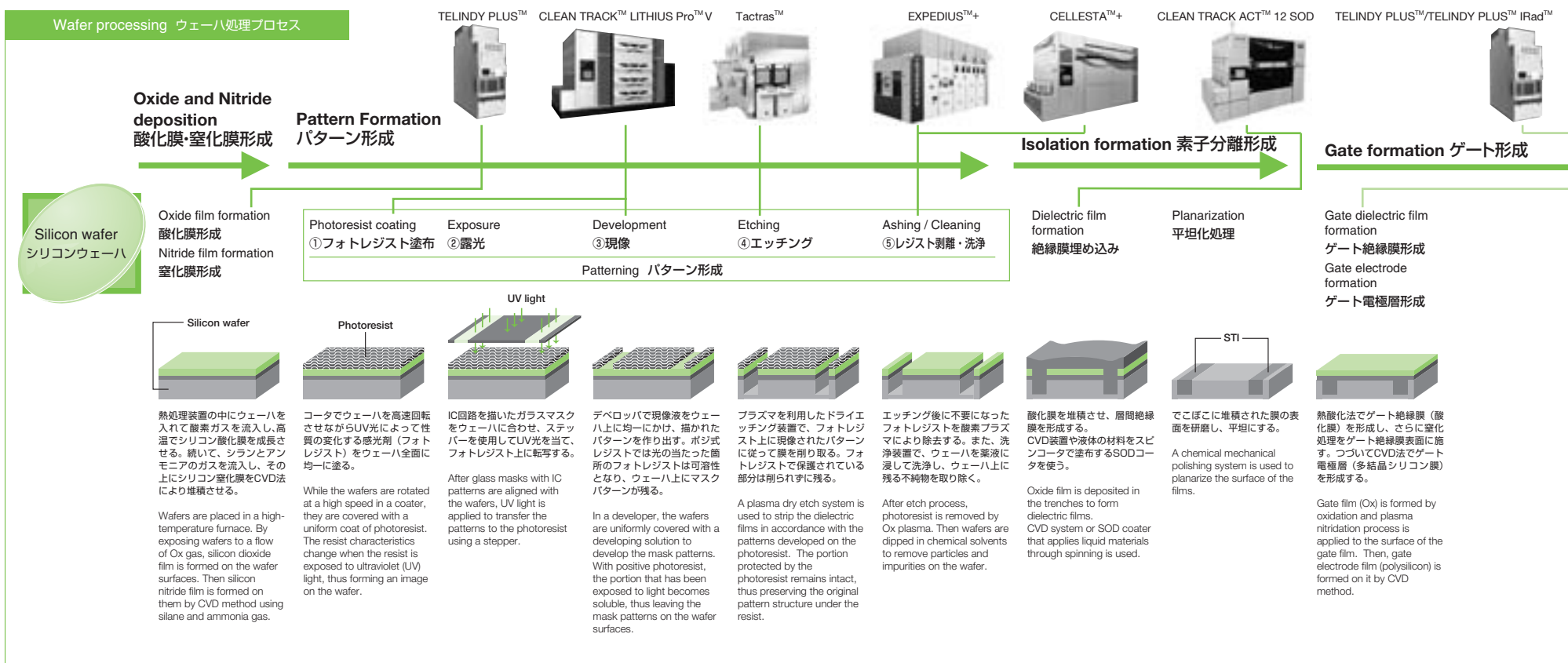
TELの連結売上高

(¥ Billion 十億円)

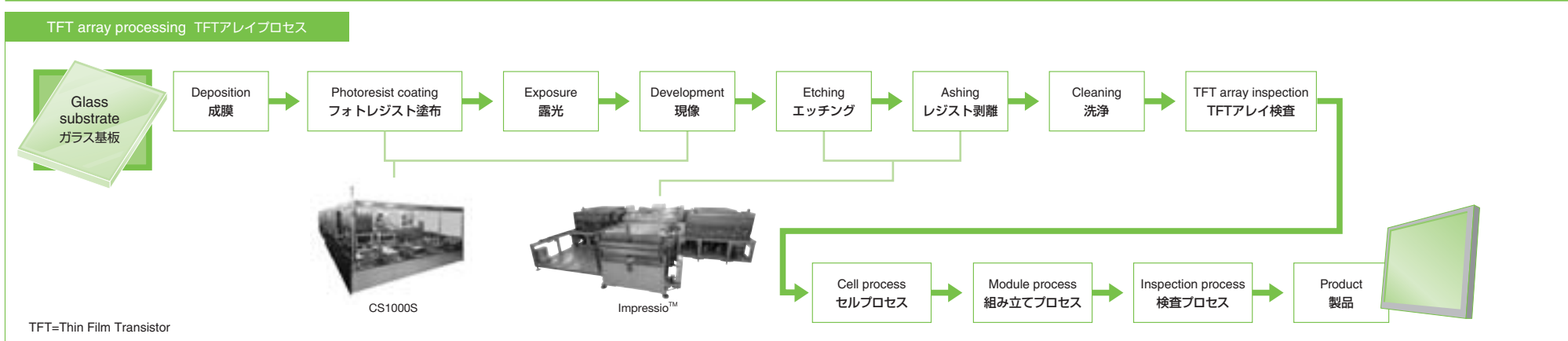


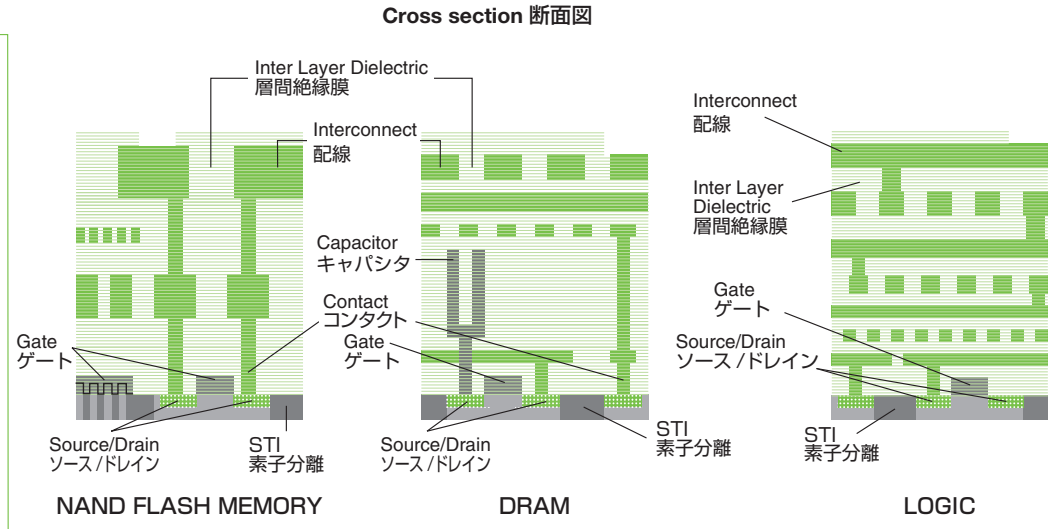
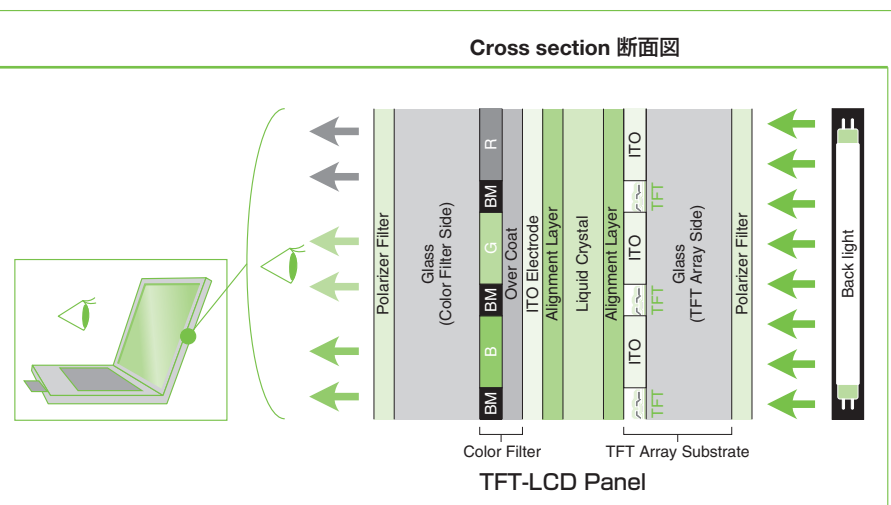
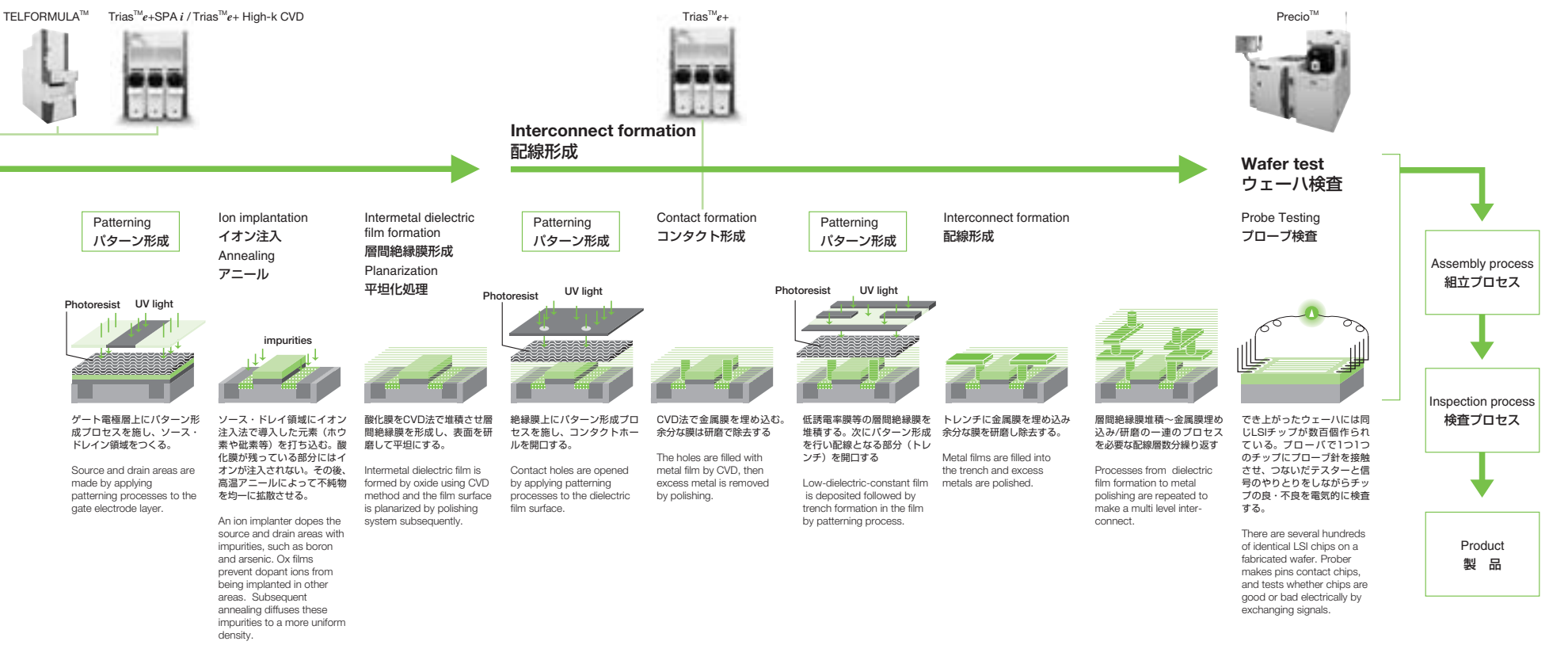
The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar.
半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程（ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス）は、ともによく似た工程です。

Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス



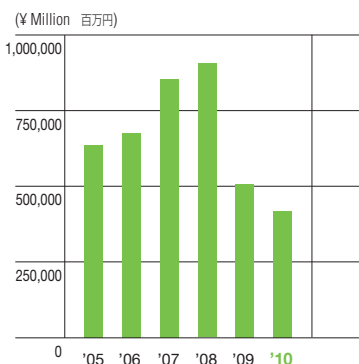
TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス



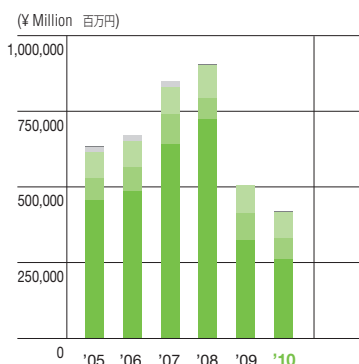


TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2010 is the fiscal year ended March 31, 2010. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2010は2010年3月31日に終了した会計年度です。

Net Sales 売上高

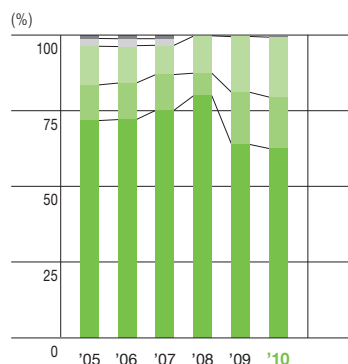


Net Sales by Division 部門別売上高

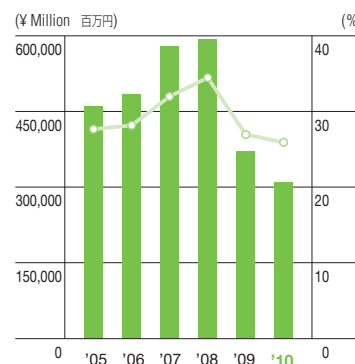


■ Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置
 ■ FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置
 ■ Electronic Components 電子部品
 ■ Computer Networks コンピュータ・ネットワーク
 ■ Others その他

Composition of Net Sales by Division 部門別売上構成比

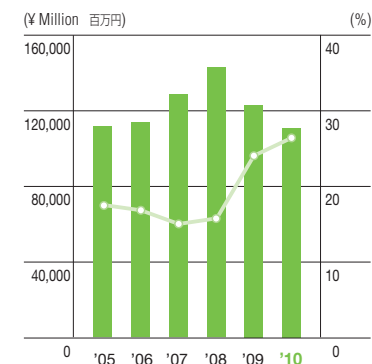


Cost of Sales and Gross Profit Margin 売上原価及び売上総利益率



■ Cost of sales 売上原価
 ○ Gross profit margin 売上総利益率

Selling, General and Administrative Expenses and Ratio to Net Sales 販売費及び一般管理費及び対売上高比率



■ SG&A expenses 販売費及び一般管理費
 ○ SG&A expenses ratio 販管費率

Electronic Components & Computer Networks reclassified from FY2008
 2008年3月期より電子部品・情報通信機器

FY 年度	FY (¥ Million 百万円)		Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置		FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置		Electronic Components 電子部品		Computer Networks コンピュータ・ネットワーク		FY (¥ Million 百万円)	
	Net sales 売上高	(% of total) 構成比									Cost of sales 売上原価	Gross profit margin 売上総利益率
2005	635,710	(100.0)	457,190	(71.9)	75,038	(11.8)	86,249	(13.6)	15,966	(2.5)	1,266	(0.2)
2006	673,686	(100.0)	486,882	(72.3)	81,176	(12.0)	86,880	(12.9)	17,497	(2.6)	1,248	(0.2)
2007	851,975	(100.0)	642,625	(75.4)	100,766	(11.8)	88,293	(10.4)	19,168	(2.2)	1,120	(0.2)
2008	906,091	(100.0)	726,439	(80.2)	68,016	(7.5)	111,181	(12.3)			454	(0.0)
2009	508,082	(100.0)	325,383	(64.0)	88,107	(17.3)	94,207	(18.6)			384	(0.1)
2010	418,636	(100.0)	262,391	(62.7)	71,361	(17.0)	84,473	(20.2)			410	(0.1)

Sales by division represents the sales to customers.
 部門別売上高は、外部顧客に対する売上高です。

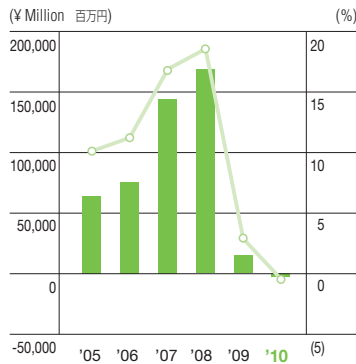
FY 年度	FY (¥ Million 百万円)		FY (¥ Million 百万円)	
	Cost of sales 売上原価	Gross profit margin 売上総利益率	SG&A expenses 販売費及び一般管理費	Ratio to net sales 対売上高比率
2005	459,797	27.7	111,929	17.6
2006	483,954	28.2	114,028	17.0
2007	579,325	32.0	128,670	15.1
2008	594,794	34.4	142,799	15.8
2009	370,673	27.0	122,697	24.1
2010	310,320	25.9	110,496	26.4

Notes: 1. From FY2005, sales of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
 2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
 4. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".
 5. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

注) 1. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高に含めていたFPD製造装置の売上高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
 2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更 (2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
 3. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
 4. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。
 5. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV (太陽電池) 製造装置の売上を合わせて開示しています。

Operating Income (Loss) and Operating Margin

営業損益及び営業利益率

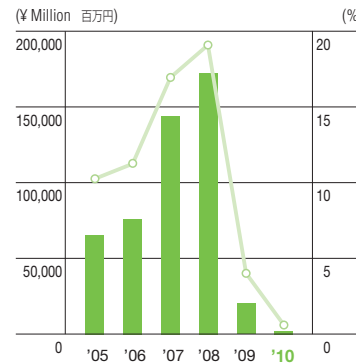


■ Operating income (loss) 営業損益
○ Operating margin 営業利益率

FY	Operating income (loss) (¥ Million)	Operating margin (%)
年度	営業損益	営業利益率
2005	63,982	10.1
2006	75,703	11.2
2007	143,978	16.9
2008	168,498	18.6
2009	14,710	2.9
2010	(2,180)	(0.5)

Ordinary Income (Loss) and Ordinary Profit Margin

経常損益及び経常利益率

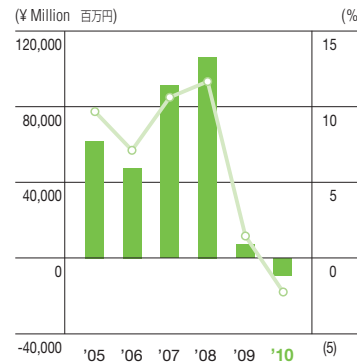


■ Ordinary income (loss) 経常損益
○ Ordinary profit margin 経常利益率

FY	Ordinary income (loss) (¥ Million)	Ordinary profit margin (%)
年度	経常損益	経常利益率
2005	65,632	10.3
2006	75,951	11.3
2007	143,940	16.9
2008	172,713	19.1
2009	20,555	4.0
2010	2,558	0.6

Net Income (Loss) and Net Income Margin

当期損益及び当期利益率

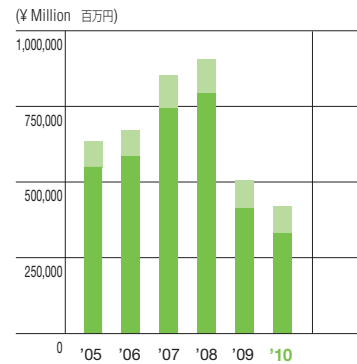


■ Net income (loss) 当期損益
○ Net income margin 当期利益率

FY	Net income (loss) (¥ Million)	Net income margin (%)
年度	当期損益	当期利益率
2005	61,601	9.7
2006	48,005	7.1
2007	91,262	10.7
2008	106,271	11.7
2009	7,543	1.5
2010	(9,033)	(2.2)

Net Sales by Business Segment

セグメント別売上高



■ Industrial Electronic Equipment 産業用電子機器事業
■ Electronic Components & Computer Networks 電子部品・情報通信機器事業

FY	Industrial Electronic Equipment (¥ Million)		Electronic Components & Computer Networks (¥ Million)	
	Industrial Electronic Equipment	(% of total)	Electronic Components & Computer Networks	(% of total)
年度	産業用電子機器事業	構成比	電子部品・情報通信機器事業	構成比
2005	550,514	(86.2)	88,079	(13.8)
2006	587,809	(86.9)	88,290	(13.1)
2007	746,893	(87.3)	108,709	(12.7)
2008	796,027	(87.7)	112,128	(12.3)
2009	414,816	(81.4)	94,701	(18.6)
2010	334,948	(79.7)	85,145	(20.3)

* 1 : Semiconductor Production Equipment, FPD/PV Production Equipment, Other 半導体製造装置、FPD/PV製造装置、その他

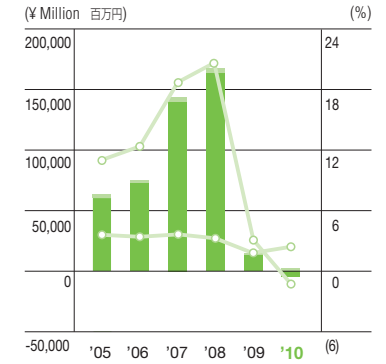
* 2 : Electronic Components, Computer Networks 電子部品、コンピュータ・ネットワーク

Sales of Computer Networks were included in segment " * 1 " before FY2006 コンピュータ・ネットワークは、2006年3月期以前は * 1 に含まれます。

Sales include inter-segment transactions. 売上高は、セグメント間取引を含んでいます。

Operating Income (Loss) and Operating Margin by Business Segment

セグメント別営業損益・営業利益率



■ Industrial Electronic Equipment 産業用電子機器事業
■ Electronic Components & Computer Networks 電子部品・情報通信機器事業
○ Operating margin 営業利益率

FY	Industrial Electronic Equipment (¥ Million)		Electronic Components & Computer Networks (¥ Million)	
	Operating income (loss)	Operating margin (%)	Operating income (loss)	Operating margin (%)
年度	営業損益	営業利益率 (%)	営業損益	営業利益率 (%)
2005	60,790	11.0	3,106	3.5
2006	72,568	12.3	3,100	3.5
2007	140,354	18.8	3,969	3.7
2008	164,807	20.7	3,658	3.3
2009	12,843	3.1	1,840	1.9
2010	(4,269)	(1.3)	2,079	2.4

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

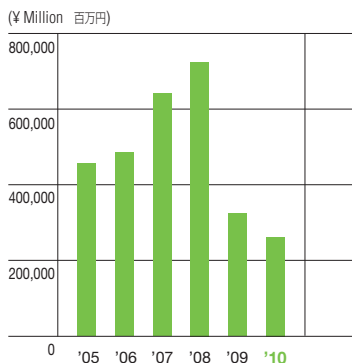
注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

3. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

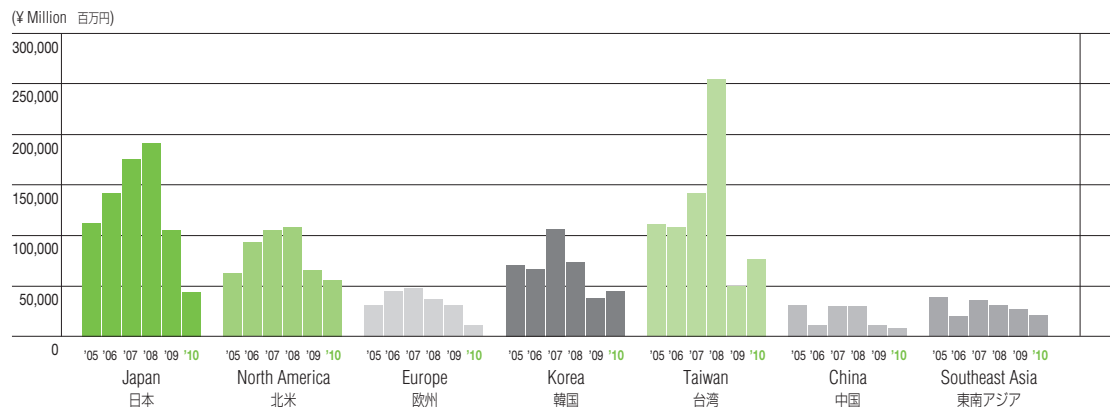
SPE Sales

半導体製造装置売上高



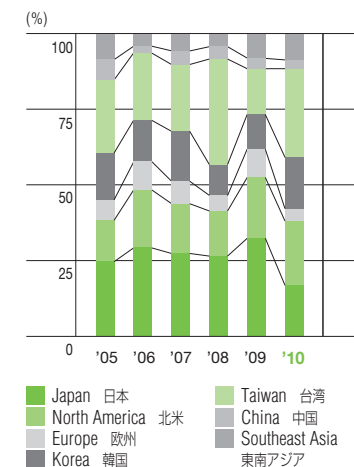
SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上構成比



FY	SPE Sales
2005	457,190
2006	486,882
2007	642,625
2008	726,439
2009	325,383
2010	262,391

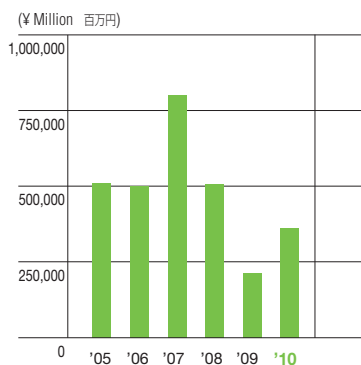
FY	Japan	North America	Europe	Korea	Taiwan	China	Southeast Asia	Total
年度	日本	北米	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア	合計
2005	112,454 (24.6)	62,725 (13.7)	31,127 (6.8)	71,051 (15.5)	110,646 (24.2)	30,668 (6.7)	38,516 (8.5)	457,190 (100.0)
2006	142,173 (29.2)	93,272 (19.2)	45,044 (9.3)	66,948 (13.8)	108,314 (22.2)	10,830 (2.2)	20,299 (4.1)	486,882 (100.0)
2007	175,731 (27.3)	105,613 (16.4)	47,963 (7.5)	106,168 (16.5)	141,794 (22.1)	29,650 (4.6)	35,702 (5.6)	642,625 (100.0)
2008	191,934 (26.4)	108,708 (15.0)	36,929 (5.1)	73,212 (10.1)	254,972 (35.1)	29,864 (4.1)	30,819 (4.2)	726,439 (100.0)
2009	105,334 (32.4)	65,374 (20.1)	30,389 (9.3)	37,546 (11.5)	49,308 (15.2)	11,087 (3.4)	26,343 (8.1)	325,383 (100.0)
2010	44,174 (16.8)	55,555 (21.2)	10,937 (4.2)	44,716 (17.0)	76,795 (29.3)	7,616 (2.9)	22,595 (8.6)	262,391 (100.0)

Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
 2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
 3. Geographical sales are classified according to sales destinations.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
 3. 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

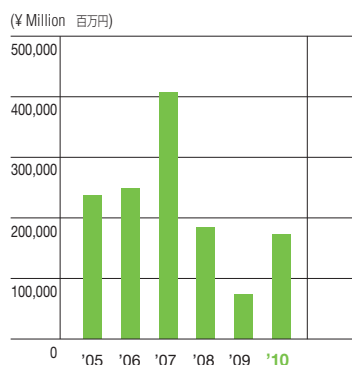
SPE Orders Received

半導体製造装置受注高



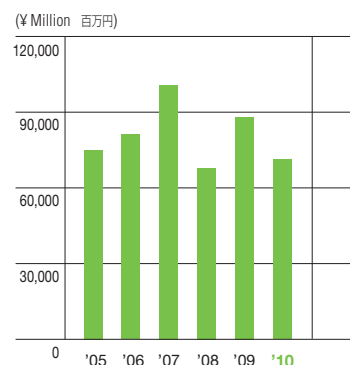
SPE Order Backlog

半導体製造装置受注残高



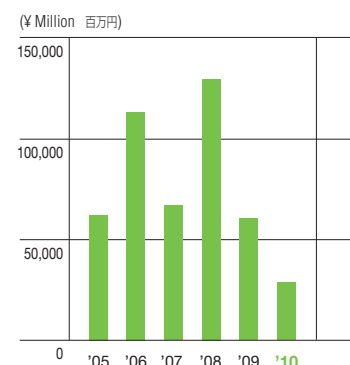
FPD/PV Production Equipment Sales

FPD/PV製造装置売上高



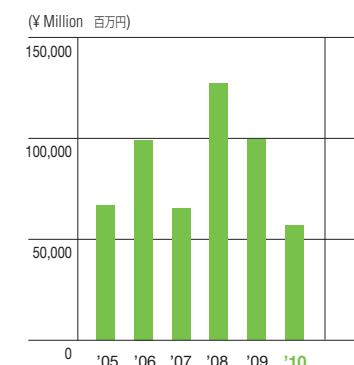
FPD/PV Production Equipment Orders Received

FPD/PV製造装置受注高



FPD/PV Production Equipment Order Backlog

FPD/PV製造装置受注残高



FY	(¥ Million 百万円) SPE orders received 半導体製造装置受注高
2005	510,536
2006	499,862
2007	800,434
2008	504,116
2009	214,517
2010	360,914

FY	(¥ Million 百万円) SPE order backlog 半導体製造装置受注残高
2005	236,179
2006	249,159
2007	406,969
2008	184,645
2009	73,780
2010	172,303

FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment sales FPD/PV製造装置売上高
2005	75,038
2006	81,176
2007	100,766
2008	68,016
2009	88,107
2010	71,361

FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment orders received FPD/PV製造装置受注高
2005	62,282
2006	113,494
2007	66,908
2008	129,906
2009	60,579
2010	28,566

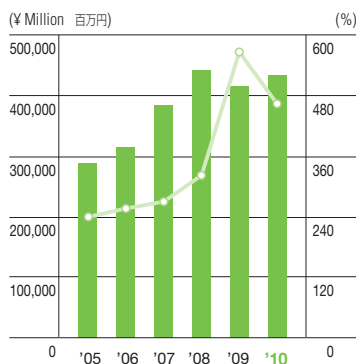
FY	(¥ Million 百万円) FPD/PV Production Equipment order backlog FPD/PV製造装置受注残高
2005	66,751
2006	99,069
2007	65,211
2008	127,101
2009	99,573
2010	56,778

Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
2. From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
3. From FY2009, sales, orders and order backlog of FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment are disclosed together.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
3. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV (太陽電池) 製造装置の売上、受注、受注残高を合わせて表示しています。

Working Capital and Current Ratio

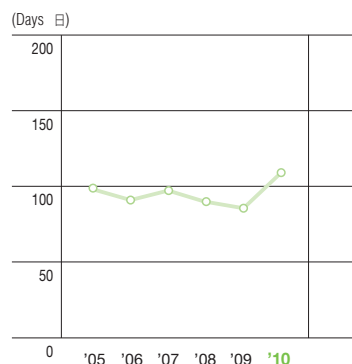
運転資本及び流動比率



■ Working capital 運転資本
○ Current ratio 流動比率

Receivable Turnover

売上債権回転日数

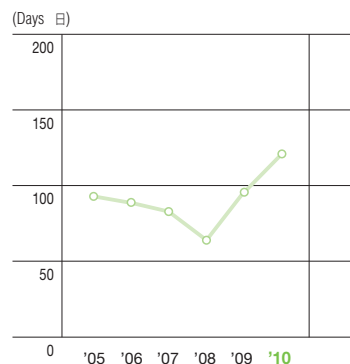


FY	Receivable turnover (Days)
2005	99
2006	92
2007	98
2008	90
2009	86
2010	109

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365
売上債権回転日数 = 期末受取手形及び売掛金 ÷ 売上高 × 365

Inventory Turnover

たな卸資産回転日数

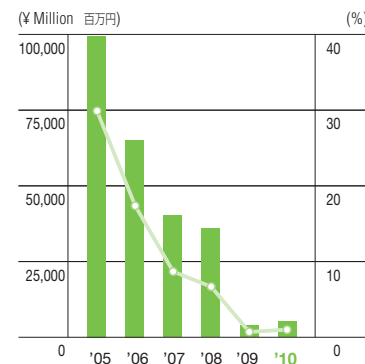


FY	Inventory turnover (Days)
2005	93
2006	89
2007	83
2008	65
2009	96
2010	121

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365
たな卸資産回転日数 = 期末たな卸資産 ÷ 売上高 × 365

Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio

有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ



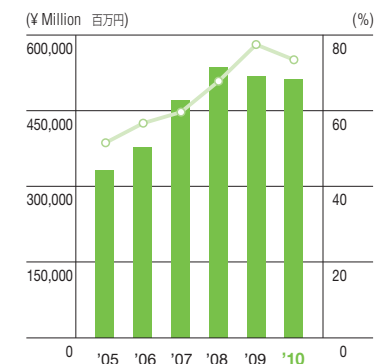
■ Interest-bearing debt 有利子負債
○ Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・レシオ

FY	Interest-bearing debt (¥ Million)	Debt-to-equity ratio (%)
2005	99,451	29.9
2006	65,100	17.3
2007	40,212	8.7
2008	36,069	6.7
2009	3,806	0.7
2010	5,105	1.0

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total equity at fiscal year-end
デット・エクイティ・レシオ = 有利子負債 ÷ 期末自己資本 × 100 (%)

Equity and Equity Ratio

自己資本及び自己資本比率



■ Equity 自己資本
○ Equity ratio 自己資本比率

FY	Equity (¥ Million)	Equity ratio (%)
2005	332,165	51.6
2006	376,900	56.8
2007	460,175	59.7
2008	534,953	67.5
2009	518,387	77.5
2010	511,818	73.5

From FY2007, Equity = Net assets – subscription rights to shares – Minority interests
2007年3月期より、自己資本 = 純資産 – 新株予約権 – 少数株主持分

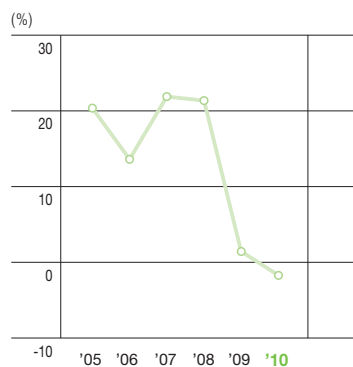
Working capital = Current assets – Current liabilities
運転資本 = 流動資産 – 流動負債
Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100
流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 (%)

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
2. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade accounts receivable.
3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
2. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。
3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Return on Equity (ROE)

自己資本利益率

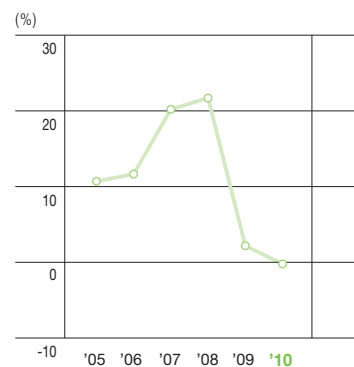


FY	ROE (%)
年度	自己資本利益率
2005	20.3
2006	13.5
2007	21.8
2008	21.4
2009	1.4
2010	(1.8)

ROE = (Net income / Average total equity) × 100
自己資本利益率 = 当期利益 ÷ 期首・期末平均自己資本 × 100 (%)

Return on Assets (ROA)

総資産利益率

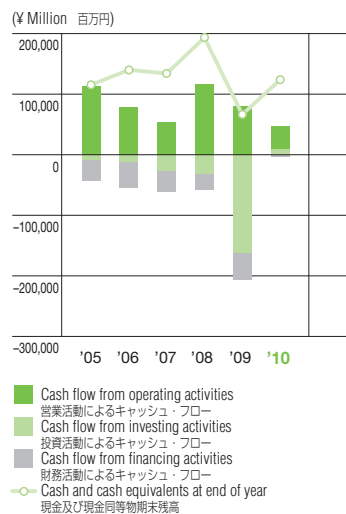


FY	ROA (%)
年度	総資産利益率
2005	10.7
2006	11.7
2007	20.2
2008	21.7
2009	2.3
2010	(0.2)

ROA = (Operating income + Interest and dividend income) / Average total assets × 100
総資産利益率 = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 期首・期末平均総資産 × 100 (%)

Cash Flows

キャッシュ・フロー

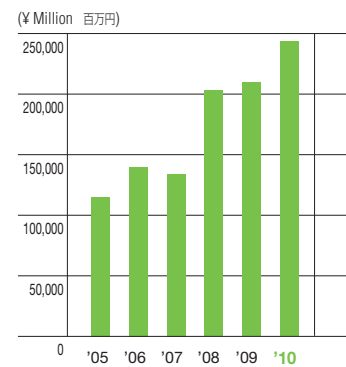


FY	Operating	Investing	Financing	Total
年度	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
2005	114,349	(7,450)	(34,343)	114,420
2006	78,853	(10,536)	(43,420)	140,023
2007	54,296	(25,293)	(34,719)	134,389
2008	116,939	(30,186)	(27,033)	193,492
2009	81,030	(160,621)	(46,015)	65,883
2010	48,284	9,613	(287)	123,939

Cash flow from investing activities includes increase / decrease in time deposits over three months.
投資活動によるキャッシュ・フローには、3ヶ月超の定期預金の増減が含まれています。

Total Liquidity on Hand

手元資金

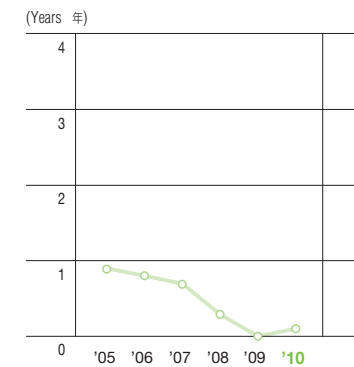


FY	Total Liquidity on Hand
年度	手元資金
2005	115,420
2006	140,023
2007	134,389
2008	203,562
2009	210,158
2010	243,939

Total liquidity on hand = Cash and cash equivalents at end of year + time deposits over three months
手元資金 = 現金及び現金同等物期末残高 + 3ヶ月超の定期預金残高

Redemption of Debt

債務償還年数



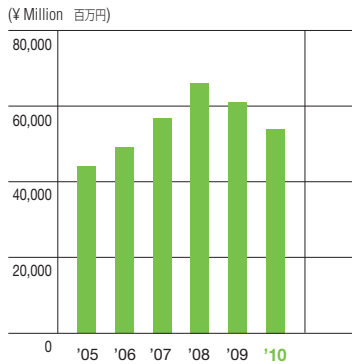
FY	Redemption of Debt
年度	債務償還年数
2005	0.9
2006	0.8
2007	0.7
2008	0.3
2009	0.0
2010	0.1

Redemption of debt = Interest-bearing debt / Cash flow from operating activities
債務償還年数 = 有利子負債 ÷ 営業活動によるキャッシュ・フロー

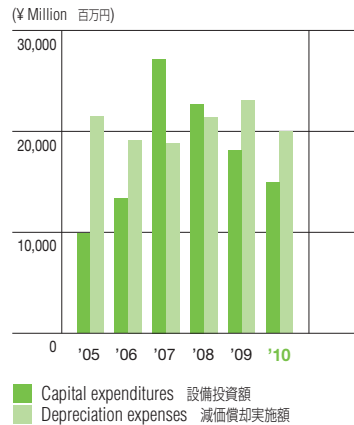
Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

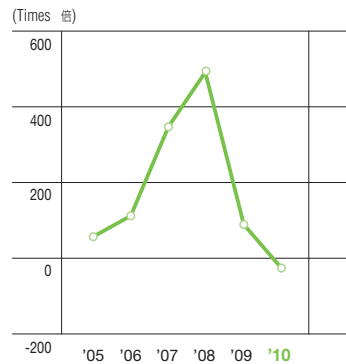
R&D Expenses 研究開発費



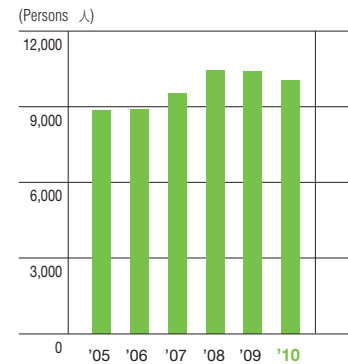
Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額



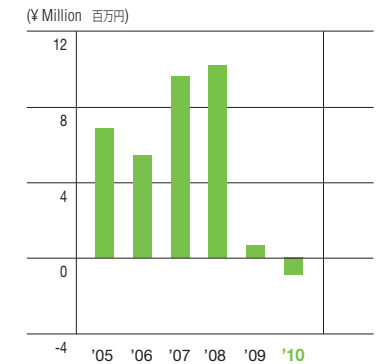
Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ



Number of Employees Worldwide 従業員数



Net Income (Loss) per Employee 従業員1人当り当期純損益



FY	R&D expenses (¥ Million)
年度	研究開発費
2005	43,888
2006	49,181
2007	56,961
2008	66,072
2009	60,987
2010	54,074

FY	Capital expenditures (¥ Million)	Depreciation expenses (¥ Million)
年度	設備投資額	減価償却実施額
2005	9,876	21,462
2006	13,334	19,170
2007	27,128	18,820
2008	22,703	21,413
2009	18,107	23,068
2010	14,918	20,001

FY	Interest coverage ratio (Times)
年度	インタレスト・カバレッジ・レシオ
2005	58.7
2006	111.0
2007	344.4
2008	494.9
2009	94.2
2010	24.2

FY	Number of employees worldwide (Persons)
年度	従業員数
2005	8,864
2006	8,901
2007	9,528
2008	10,429
2009	10,391
2010	10,068

FY	Net income (loss) per employee (¥ Million)
年度	従業員1人当り当期純損益
2005	6.9
2006	5.4
2007	9.6
2008	10.2
2009	0.7
2010	(0.9)

Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses
 インタレスト・カバレッジ・レシオ = (営業利益 + 受取利息及び配当金) ÷ 支払利息 (倍)

Notes: 1. Amortization of goodwill is not included in depreciation expenses.

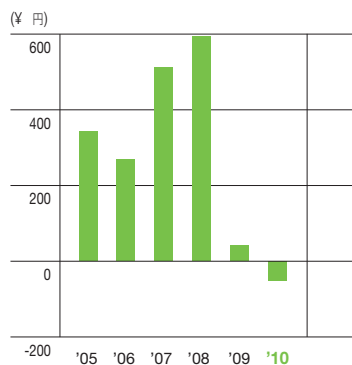
2. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 減価償却実施額には、のれん償却額は含まれておりません

2. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Net Income (Loss) per Share

1株当り当期純損益

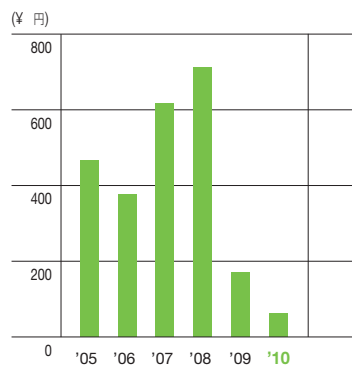


FY	Net income (loss) per share
2005	343.63
2006	267.61
2007	511.27
2008	594.01
2009	42.15
2010	(50.47)

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
 1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失) ÷ 期中平均発行済株式総数

Cash Flow per Share

1株当りキャッシュ・フロー

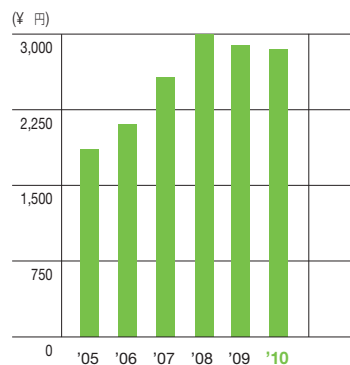


FY	Cash flow per share
2005	465.99
2006	377.08
2007	616.71
2008	713.70
2009	171.07
2010	61.28

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year
 1株当りキャッシュ・フロー = (当期利益 + 減価償却費) ÷ 期中平均発行済株式総数

Net Assets per Share

1株当り純資産

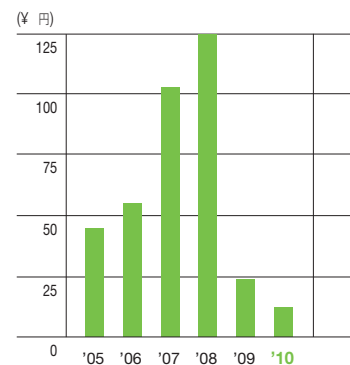


FY	Net assets per share
2005	1,863.28
2006	2,112.30
2007	2,573.72
2008	2,989.70
2009	2,896.55
2010	2,859.37

Net assets per share = Net assets / Total number of shares issued
 1株当り純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式総数

Cash Dividends per Share

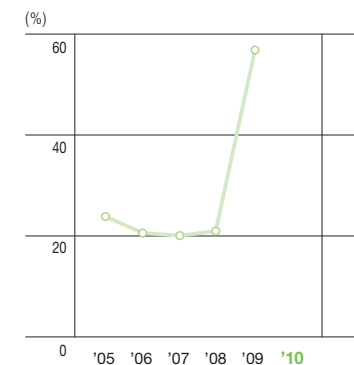
1株当り配当金



FY	Cash dividends per share
2005	45.00
2006	55.00
2007	103.00
2008	125.00
2009	24.00
2010	12.00

Payout Ratio

配当性向



FY	Payout ratio
2005	23.9
2006	20.6
2007	20.1
2008	21.0
2009	56.9
2010	-

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share × 100
 配当性向 = 1株当り配当金額 ÷ 単独1株当り当期純利益 × 100 (%)

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
 4. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.

注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
 2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
 4. 1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Assets 資産の部											
Current assets 流動資産											
Cash and deposits 現金及び預金	79,518	65,320	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	67,540	51,156	56,939
Securities 有価証券	834	—	10	—	—	—	—	19	136,022	159,001	187,000
Trade notes and accounts receivable 受取手形・売掛金	165,053	287,968	157,414	170,286	231,044	172,487	169,038	228,688	224,170	119,687	124,462
Inventories たな卸資産	112,481	161,980	127,352	111,810	105,186	161,489	163,745	194,840	161,151	134,242	138,450
Deferred income taxes 繰延税金資産	5,305	12,658	3,401	4,151	2,943	18,172	21,356	28,325	24,140	11,480	26,625
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(1,028)	(1,720)	(620)	(341)	(154)	(114)	(164)	(127)	(62)	(20)	(176)
Others その他	12,991	22,033	17,455	17,549	21,303	27,730	23,488	24,225	27,271	30,139	19,638
Total current assets 流動資産合計	375,157	548,241	353,423	356,438	402,974	495,185	517,487	610,363	640,233	505,687	552,939
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	1,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Property, plant and equipment 有形固定資産											
Total property, plant and equipment 有形固定資産	174,746	211,911	235,247	231,085	223,226	221,752	227,354	244,422	244,241	251,428	249,468
Accumulated depreciation 減価償却累計額	(77,019)	(87,190)	(100,736)	(111,474)	(114,437)	(123,336)	(132,616)	(139,492)	(140,135)	(151,521)	(157,340)
Net property, plant and equipment 有形固定資産合計	97,726	124,720	134,510	119,611	108,788	98,416	94,738	104,930	104,105	99,906	92,127
Intangible assets 無形固定資産	5,696	27,524	28,753	25,342	21,512	18,611	16,709	19,399	13,253	10,760	5,586
Investments and other assets 投資その他の資産											
Investment securities 投資有価証券	9,009	11,599	9,535	7,216	10,873	10,381	14,860	14,642	8,837	9,131	14,720
Deferred income taxes 繰延税金資産	2,144	7,394	22,591	9,362	10,203	15,313	13,174	13,691	14,846	31,939	20,505
Allowance for doubtful accounts 貸倒引当金	(234)	(242)	(285)	(431)	(311)	(367)	(374)	(297)	(301)	(7,545)	(7,452)
Others その他	8,905	10,274	8,387	7,362	7,590	6,779	6,646	7,784	11,843	19,118	17,924
Total investments and other assets 投資その他の資産合計	19,826	29,025	40,227	23,509	28,356	32,106	34,307	35,821	35,224	52,644	45,698
Total assets 資産合計	499,499	729,511	556,915	524,901	561,631	644,319	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351

Notes: 1. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.
2. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.
3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:
(1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
5. From FY2008, certificates of deposit that were previously included in cash and cash equivalents are classified as securities.
6. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

注) 1. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
2. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。
3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
5. 2008年3月期より、従来現金及び預金に含めていた譲渡性預金を有価証券に含めて表示しています。
6. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Liabilities and Net Assets 負債及び純資産の部											
Current liabilities 流動負債											
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	23,997	78,462	23,923	43,729	6,815	975	2,100	1,712	6,069	3,806	5,105
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	32,698	2,969	26,387	37,403	21,753	35,475	24,500	8,500	30,000	—	—
Trade notes and accounts payable 支払手形及び買掛金	50,103	60,541	26,625	36,676	65,419	58,229	65,816	83,837	55,332	24,393	52,359
Customer advances 前受金	1,258	1,817	1,613	1,504	12,141	42,970	33,810	21,956	24,028	28,562	22,077
Income taxes payable 未払法人税等	11,843	41,440	1,663	3,645	3,272	13,357	22,895	45,657	28,239	1,751	4,355
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	7,375	10,948	2,463	3,629	6,376	8,644	10,230	14,131	12,726	4,965	6,043
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	—	—	—	—	—	13,105	12,219	14,114	9,815	6,115	5,267
Others その他	19,181	42,261	26,825	34,118	25,692	33,852	30,054	35,945	32,608	19,678	23,952
Total current liabilities 流動負債合計	146,457	238,441	109,501	160,705	141,472	206,611	201,627	225,854	198,820	89,272	119,161
Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債	67,277	126,347	105,451	70,229	98,475	63,000	38,500	30,000	—	—	—
Accrued pension and severance costs 退職給付引当金	11,581	28,698	31,714	35,317	37,575	35,632	38,034	40,018	43,704	47,046	49,906
Other liabilities その他の固定負債	545	2,683	2,610	2,148	4,362	2,499	3,459	4,829	5,047	3,413	3,913
Total liabilities 負債合計	225,861	396,171	249,278	268,401	281,885	307,743	281,621	300,702	247,572	139,732	172,982
Minority interest 少数株主持分	34	58	58	3,595	3,946	4,410	4,721	—	—	—	—
Net assets 純資産											
Common stock 資本金	47,163	47,212	47,213	47,223	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剰余金	70,225	70,274	70,275	70,285	78,023	78,023	78,078	78,346	78,392	78,114	78,034
Retained earnings 利益剰余金	157,875	214,920	190,195	147,464	154,342	212,093	249,938	328,026	410,866	404,435	393,970
Treasury stock at cost 自己株式	(1,661)	(3,519)	(5,014)	(13,238)	(13,203)	(16,042)	(15,116)	(12,167)	(11,369)	(11,111)	(10,900)
Total shareholders' equity 株主資本合計	—	—	—	—	—	—	—	449,166	532,850	526,398	516,065
Unrealized gains on securities その他有価証券評価差額金	—	1,658	1,170	(58)	2,395	2,132	5,117	5,853	2,172	(842)	2,504
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	—	—	—	—	—	—	—	(177)	460	66	(67)
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定	—	2,734	3,737	1,228	(719)	997	3,921	5,332	(529)	(7,235)	(6,683)
Total valuation and translation adjustments 評価・換算差額等合計	—	—	—	—	—	—	—	11,008	2,102	(8,011)	(4,247)
Share subscription rights 新株予約権	—	—	—	—	—	—	—	584	483	1,148	1,578
Minority interests 少数株主持分	—	—	—	—	—	—	—	9,051	9,807	9,729	9,973
Total net assets 純資産合計	273,602	333,281	307,578	252,904	275,799	332,165	376,900	469,810	545,244	529,265	523,369
Total liabilities and net assets 負債及び純資産合計	499,499	729,511	556,915	524,901	561,631	644,319	663,242	770,513	792,817	668,998	696,351

- Notes: 1. From FY2001, the Company adopts new accounting standards for retirement benefits.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
5. From FY2009, the Company adopts "Accounting Standard for Lease Transactions".

- 注) 1. 2001年3月期から退職給付に係る新しい会計基準を適用しています。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
4. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
5. 2009年3月期より、「リース取引に関する会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Net sales 売上高	440,728	723,880	417,825	460,580	529,653	635,710	673,686	851,975	906,091	508,082	418,636
Cost of sales 売上原価	303,838	458,902	302,270	326,539	389,498	459,797	483,954	579,325	594,794	370,673	310,320
Gross profit 売上総利益	136,890	264,978	115,555	134,040	140,155	175,912	189,731	272,649	311,297	137,408	108,316
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	101,074	143,891	133,865	132,921	117,875	111,929	114,028	128,670	142,799	122,697	110,496
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	35,816	121,086	(18,310)	1,118	22,279	63,982	75,703	143,978	168,498	14,710	(2,180)
Non-operating income 営業外収益	1,608	1,628	1,796	2,208	2,659	4,533	3,589	4,908	5,131	6,809	5,331
Non-operating expenses 営業外費用	3,585	3,491	2,950	3,557	3,771	2,883	3,340	4,946	916	964	591
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	33,838	119,223	(19,464)	(230)	21,167	65,632	75,951	143,940	172,713	20,555	2,558
Unusual or infrequent profit 特別利益	908	184	1,471	624	632	7,777	1,141	2,721	3,020	85	299
Unusual or infrequent loss 特別損失	5,058	20,275	4,927	23,405	6,864	17,634	1,765	2,247	6,513	11,004	10,626
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期利益 (損失)	29,689	99,131	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)
Income taxes 法人税等											
Current 法人税・住民税及び事業税	14,544	50,588	2,612	4,805	5,107	15,540	29,190	60,132	56,568	4,552	5,747
Deferred 法人税等調整額	(4,708)	(13,489)	(5,602)	13,726	1,015	(21,970)	(2,352)	(7,534)	5,373	(2,762)	(5,020)
Minority interests 少数株主利益	5	20	8	12	515	603	484	553	1,005	303	539
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	19,847	62,011	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,005	91,262	106,271	7,543	(9,033)

Notes: 1. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.

2. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.

3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Directors' Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".

注) 1. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。

2. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。

3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更

4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

5. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー											
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期純利益 (損失)	29,689	99,131	(22,919)	(23,010)	14,935	55,775	75,328	144,414	169,219	9,636	(7,767)
Depreciation and amortization 減価償却費	19,445	21,678	26,294	27,373	24,962	21,462	19,170	18,820	21,413	23,068	20,001
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	(31,675)	(121,668)	131,251	(13,661)	(61,789)	59,114	5,144	(58,352)	2,473	102,412	(4,890)
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	(27,196)	(53,665)	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)	(5,467)	(31,584)	28,342	21,282	(4,868)
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	22,415	9,709	(34,166)	10,351	29,153	(7,440)	6,743	17,236	(27,373)	(29,942)	27,975
Income taxes paid 法人税の支払額	(3,757)	(19,596)	(43,848)	(527)	(6,960)	(4,774)	(19,524)	(37,785)	(73,721)	(40,836)	5,679
Others その他	16,203	34,968	(7,412)	24,757	12,906	50,125	(2,539)	1,548	(3,414)	(4,590)	12,155
Net cash provided by (used in) operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	25,126	(29,442)	77,558	21,393	7,883	114,349	78,853	54,296	116,939	81,030	48,284
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー											
Payment into time deposits 定期預金の預入による支出	—	(30)	—	—	—	—	—	(30,000)	(44,070)	(353,803)	(449,000)
Proceeds from time deposits 定期預金の払戻による収入	150	—	30	—	—	—	—	30,000	34,000	219,429	473,347
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(14,577)	(39,155)	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,679)	(8,600)	(25,153)	(19,338)	(17,227)	(14,194)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(4,100)	(4,568)	(5,390)	(2,779)	(3,200)	(1,780)	(2,610)	(2,462)	(4,041)	(1,182)	(786)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	—	(18,867)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Others その他	2,335	262	577	2,538	2,186	3,009	674	2,323	3,263	(7,836)	247
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	(16,192)	(62,359)	(35,789)	(7,269)	(8,544)	(7,450)	(10,536)	(25,293)	(30,186)	(160,621)	9,613
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー											
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	26,143	83,778	(51,681)	(4,011)	(8,624)	(27,618)	(34,438)	(24,904)	(4,148)	(32,262)	1,299
Dividends paid 配当金の支払額	(2,095)	(4,733)	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,742)	(9,795)	(12,843)	(23,431)	(13,420)	(1,431)
Others その他	(478)	(1,863)	(1,501)	(4,476)	(237)	(2,982)	813	3,027	546	(332)	(155)
Net cash provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	23,569	77,182	(57,213)	(9,883)	(10,270)	(34,343)	(43,420)	(34,719)	(27,033)	(46,015)	(287)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額	(468)	391	(1,436)	332	599	214	(340)	81	(617)	(2,068)	445
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額	32,036	(14,228)	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770	24,555	(5,634)	59,103	(127,676)	58,056
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高	46,760	79,518	65,290	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492	65,883
Effect of newly consolidated subsidiary 新規連結子会社の影響	721	—	—	—	—	—	48	—	—	67	—
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	79,518	65,290	48,409	52,982	42,649	115,420	140,023	134,389	193,492	65,883	123,939

(¥ Million 百万円)

Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2004				2005					2006			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	1H	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Net sales 売上高	87,778	133,637	121,234	187,002	280,199		149,409	206,101		160,016	173,122	145,058	195,488
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	65,320	106,912	96,496	157,017	206,063		102,050	149,076		113,984	125,274	104,568	143,054
FPD/PV Production Equipment FPD/PV製造装置					21,014		25,266	28,757		23,914	19,122	16,663	21,475
Electronic Components 電子部品	18,768	21,141	20,619	23,698	45,136		18,679	22,432		18,603	23,306	20,273	24,697
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	3,397	5,244	3,815	5,989	7,357		3,123	5,486		3,189	5,089	3,289	5,929
Others その他	291	338	302	296	627		289	349		323	329	263	331
Cost of sales 売上原価	66,607	98,539	91,461	132,889	203,497		106,991	149,308		113,512	130,400	100,141	139,899
Gross profit 売上総利益	21,171	35,097	29,772	54,113	76,702		42,417	56,792		46,503	42,721	44,917	55,589
Gross profit margin 売上総利益率	24.1%	26.3%	24.6%	28.9%	27.4%		28.4%	27.6%		29.1%	24.7%	31.0%	28.4%
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	29,465	31,598	25,592	31,218	56,426		25,403	30,099		24,770	28,212	27,956	33,090
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	(8,294)	3,499	4,180	22,894	20,275		17,013	26,693		21,733	14,509	16,961	22,499
Operating margin 営業利益率	(9.4%)	2.6%	3.4%	12.2%	7.2%		11.4%	13.0%		13.6%	8.4%	11.7%	11.5%
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	(8,740)	3,115	4,040	22,751	20,984		17,410	27,237		21,717	15,037	16,965	22,231
Ordinary profit margin 経常利益率	(10.0%)	2.3%	3.3%	12.2%	7.5%		11.7%	13.2%		13.6%	8.7%	11.7%	11.4%
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期利益 (損失)	(9,001)	407	3,808	19,721	7,943		17,354	30,476		22,083	14,490	16,983	21,769
Ratio of income before income taxes to net sales 税金等調整前当期利益率	(10.3%)	0.3%	3.1%	10.5%	2.8%		11.6%	14.8%		13.8%	8.4%	11.7%	11.1%
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	(10,366)	559	2,751	15,352	1,272		13,401	46,927		13,237	10,741	10,147	13,879
Net income margin 当期純利益率	(11.8%)	0.4%	2.3%	8.2%	0.5%		9.0%	22.8%		8.3%	6.2%	7.0%	7.1%

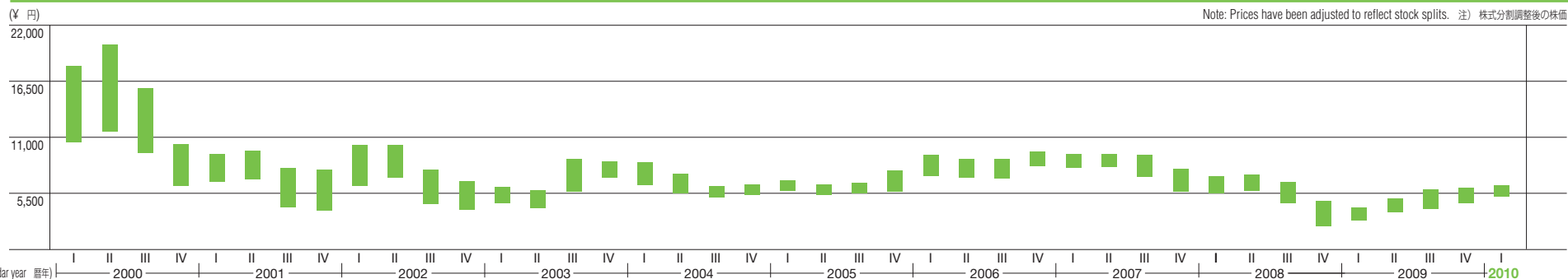
(¥ Million 百万円)

2007				2008				2009				2010			
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
179,205	211,357	210,093	251,318	212,494	263,883	199,837	229,876	154,827	146,398	101,088	105,767	68,915	84,975	114,289	150,456
125,925	157,980	158,828	199,891	165,785	213,465	160,739	186,449	112,546	96,156	57,827	58,852	30,437	51,699	76,511	103,743
28,932	23,636	26,023	22,173	21,400	22,200	10,048	14,367	17,264	22,915	20,370	27,557	19,943	10,799	16,686	23,931
21,042	24,011	21,141	22,098	25,175	28,095	28,980	28,929	24,923	27,202	22,835	19,246	18,445	22,354	21,028	22,644
3,009	5,438	3,857	6,862												
294	290	242	293	132	121	69	130	93	124	55	110	89	121	63	136
124,765	146,405	136,150	172,004	135,907	175,110	127,411	156,364	102,729	107,441	73,974	86,529	57,715	65,305	82,056	105,243
54,439	64,951	73,943	79,314	76,586	88,773	72,426	73,511	52,098	38,957	27,114	19,238	11,199	19,670	32,232	45,213
30.4%	30.7%	35.2%	31.6%	36.0%	33.6%	36.2%	32.0%	33.6%	26.6%	26.8%	18.2%	16.3%	23.1%	28.2%	30.1%
28,575	32,575	31,038	36,481	33,551	36,802	33,927	38,518	30,668	34,104	29,115	28,809	25,588	26,902	26,710	31,294
25,864	32,376	42,904	42,833	43,034	51,970	38,499	34,993	21,430	4,852	(2,001)	(9,570)	(14,388)	(7,232)	5,521	13,918
14.4%	15.3%	20.4%	17.0%	20.3%	19.7%	19.3%	15.2%	13.8%	3.3%	(2.0%)	(9.0%)	(20.9%)	(8.5%)	4.8%	9.3%
26,739	31,465	42,116	43,620	41,175	54,620	39,761	37,155	22,263	6,644	(74)	(8,278)	(14,021)	(5,191)	6,573	15,198
14.9%	14.9%	20.0%	17.4%	19.4%	20.7%	19.9%	16.2%	14.4%	4.5%	(0.1%)	(7.8%)	(20.3%)	(6.1%)	5.8%	10.1%
27,320	31,173	42,120	43,799	42,483	55,718	40,015	31,002	22,253	6,439	(8,494)	(10,562)	(18,406)	(7,842)	3,705	14,776
15.2%	14.7%	20.0%	17.4%	20.0%	21.1%	20.0%	13.5%	14.4%	4.4%	(8.4%)	(10.0%)	(26.7%)	(9.2%)	3.2%	9.8%
16,282	20,942	26,987	27,050	26,192	36,270	25,600	18,207	12,853	4,508	(7,686)	(2,132)	(11,035)	(5,125)	(58)	7,186
9.1%	9.9%	12.8%	10.8%	12.3%	13.7%	12.8%	7.9%	8.3%	3.1%	(7.6%)	(2.0%)	(16.0%)	(6.0%)	(0.1%)	4.8%

- Notes: 1. Sales of FPD production equipment until FY2004 are included in the sales of semiconductor production equipment.
2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
3. As changes in accounting policies were made in the second quarter (2Q) of FY2005, aggregate figures for the first quarter (1Q) and the second quarter (2Q) of FY2005 are provided.
4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
5. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination".
6. From FY2008, sales of "Electronic components" and "Computer networks", which were disclosed separately, are combined as "Electronic Components & Computer Networks".
7. From FY2009, FPD production equipment and PV (Photovoltaic Cell) production equipment sales are disclosed together.

- 注) 1. 2004年3月期までのFPD製造装置売上高は、半導体製造装置売上高に含まれています。
2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法に変更
3. 会計方針の変更が2005年3月期の第2四半期に行なわれたため、2005年3月期の第1四半期と第2四半期の数字につきましては合算にて表示しています。
4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
5. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
6. 2008年3月期より、従来電子部品およびコンピュータ・ネットワークで個別に開示していた売上高を、電子部品・情報通信機器として開示しています。
7. 2009年3月期より、FPD製造装置とPV(太陽電池)製造装置の売上を合わせて開示しています。

Stock Price Range 株価の推移



Years ended March 31	各3月31日までの1年間	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
High (¥)	高値 (円)	18,000	20,090	10,260	10,280	8,920	7,390	9,270	9,650	9,410	7,360	6,290
Low (¥)	安値 (円)	6,080	6,240	3,820	3,870	4,070	5,110	5,350	6,980	5,540	2,305	3,640

Note: Prices have been adjusted to reflect stock splits. 注) 株式分割調整後の株価

PER (Times)	High	株価収益率 (倍)	最高	158.5	56.8	—	—	192.4	21.5	34.6	18.9	15.8	174.6	—
	Low		最低	53.6	17.6	—	—	87.8	14.9	20.0	13.7	9.3	54.7	—
PBR (Times)	High	株価純資産倍率 (倍)	最高	11.5	10.6	5.8	7.1	5.8	4.0	4.4	3.7	3.1	2.5	2.2
	Low		最低	3.9	3.3	2.2	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	1.9	0.8	1.3
PCFR (Times)	High	株価キャッシュ・フロー倍率 (倍)	最高	80.1	42.1	282.6	—	47.4	15.9	24.6	15.6	13.2	43.0	102.6
	Low		最低	27.1	13.1	105.2	—	21.6	11.0	14.2	11.3	7.8	13.5	59.4

Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 ÷ 1株当り純資産

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Number of shares issued (Thousand) 発行済株式数 (千株)	175,660	175,691	175,691	175,698	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)	2,722.7	1,454.7	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5	1,466.6	1,488.2	1,094.5	657.4	1,119.8	

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式時価 × 発行済株式数

Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償・公募

Date of issue 発行年月日	Subscribed shares (Thousands) 発行株式数 (千株)	Issuing price (¥) 発行価格 (円)	
June 2, 1980	1980年6月2日	4,131	1,540
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000	4,730
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000	3,050
May 6, 1983	1983年5月6日	20	2,550
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000	4,015
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000	3,233

Stock Splits 株式分割

Date of issue 発行年月日	Ratio of distribution 分割比率	
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2010 2010年3月31日現在

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	20,938	11.6%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	14,132	7.8%
Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. 株式会社東京放送ホールディングス	8,727	4.8%
The Chase Manhattan Bank 385036 ザチェースマンハッタンバンク 385036	4,994	2.8%
JP Morgan Securities Japan Co., Ltd. JPモルガン証券株式会社	3,287	1.8%

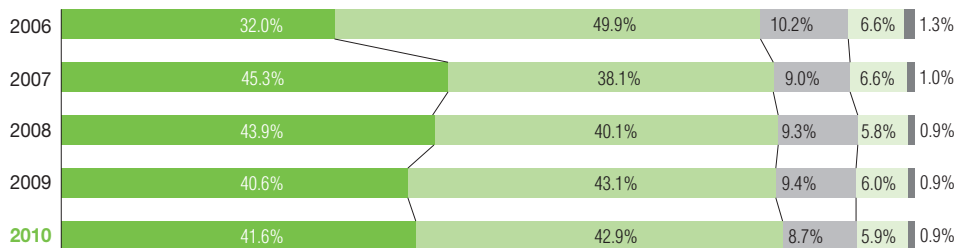
Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率 (%)
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (Investment trust account) 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口)	3,003	1.7%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	1.7%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account 9) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	2,973	1.6%
JP Morgan Chase Bank 380055 JPモルガン チェース バンク 380055	2,515	1.4%
State Street Bank and Trust Company ステートストリートバンク アンド トラストカンパニー	2,371	1.3%

Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

As of March 31, 2010 2010年3月31日現在

Category 区分	2006			2007			2008			2009			2010		
	Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition			Number of shareholders/ Shares (Thousands)/Composition		
	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比	株主数	株式数 (千株)	構成比
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社	202	57,748	32.0%	256	81,793	45.3%	262	79,240	43.9%	188	73,325	40.6%	165	75,221	41.6%
Foreign institutions and others 外国法人等	600	90,081	49.9%	623	68,775	38.1%	639	72,365	40.1%	643	77,898	43.1%	644	77,530	42.9%
Japanese individuals and others 個人・その他	44,930	18,408	10.2%	39,837	16,247	9.0%	41,871	16,739	9.3%	41,232	16,958	9.4%	38,075	15,658	8.7%
Other Japanese corporations その他の法人	539	12,037	6.6%	572	11,983	6.6%	551	10,588	5.8%	445	10,785	6.0%	400	10,586	5.9%
Treasury stock 自己株式	1	2,336	1.3%	1	1,813	1.0%	1	1,679	0.9%	1	1,643	0.9%	1	1,614	0.9%
Total 合計	46,272	180,611	100.0%	41,289	180,611	100.0%	43,324	180,611	100.0%	42,509	180,611	100.0%	39,285	180,611	100.0%

Number of shareholders and shares includes number of odd lot shareholders and odd lot shares.
株主数及び株式数は、単元未満株主数及び単元未満株式数を含んでいます。



■ Japanese financial institutions and securities companies 金融機関・証券会社
■ Foreign institutions and others 外国法人等
■ Japanese individuals and others 個人・その他
■ Other Japanese corporations その他の法人
■ Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED



World Headquarters

Akasaka Biz Tower
3-1, Akasaka 5-chome
Minato-ku, Tokyo 107-6325, Japan
Tel: +81-3-5561-7000
Fax: +81-3-5561-7400
URL: <http://www.tel.com>

Investor Relations

Corporate Communications Dept.

Tel: +81-3-5561-7003
Fax: +81-3-5561-7400

Printed on recycled paper.
本誌は再生紙を使用しています。

Printed in Japan
PR48-101